

[報道関係各位] 【2019年11月8日】

CES2020 Innovation Awards 受賞のお知らせ

ヒロセ電機がEV・HEVの基幹製品であるインバータ・モーターコントローラ等パワートレインの内部接続用に開発した、140℃耐熱・高耐振構造基板対基板フローティングコネクタ “FX26 シリーズ”と、WiGig や 5G といった次世代高速通信用に開発したマルチ RF 対応基板対基板コネクタ “BM46 シリーズ”が米国 ラスベガスで開催される電子機器の展示会 CES 2020 の Vehicle Intelligence & Transportation 部門と(FX26) Mobile Devices & Accessories 部門(BM46)で CES2020 Innovation Awards をダブル受賞いたしました。

ヒロセ電機は CES2020 への出展を予定しており、これらの製品をエントリーしておりました。展示会期間中はブースにて受賞製品を展示いたします。

**● CES2020 の Innovation Awards について**

CES は、Consumer Technology Association (CTA、全米民生技術協会) が主催し、毎年 1 月にアメリカのラスベガスで開催されるコンシューマ・エレクトロニクス分野における世界最大規模の見本市です。

「CES Innovation Awards」は、28 の製品分野で注目すべき製品を表彰するもので、製品の品質、デザインの美しさ、ユーザーに提供する価値、製品仕様の独自性と新しさ、他の製品と比較した革新性という評価基準で審査される国際的な賞です。

CES 2020 Innovation Awards (英語) :

<https://www.ces.tech/Events-Programs/Innovation-Awards/Honorees.aspx>

● 特長 FX26 シリーズ

FX26 シリーズは、EV・HEV の基幹製品であるインバータ・モーターコントローラ等パワートレインの内部接続用に開発された、140℃耐熱・高耐振構造基板対基板フローティングコネクタです。従来、駆動系装置の内部接続には基板対ケーブルコネクタが多用されていましたが、EV・HEV の生産台数が飛躍的に増加する中でそのようなコネクタは組立性とコストにおいて顧客要求を満足することが難しくなっています。一方、基板対基板コネクタは耐熱・耐振性と小型化に課題があり、普及が進んでいませんでした。



FX26 シリーズはパワートレイン内部接続向けでも安心して使って頂ける品質を達成しており、従来のケーブルコネクタ置き換えによる組立性の向上とトータルコストの低減をサポートします。さらに、端子間 1mm の狭ピッチを実現したことで、小型化も実現。アプリケーションの小型化を可能にし、セットの付加価値向上に寄与します。

FX26 が有するこれらの特長をご評価いただき、多くのお客様のご採用・引合いを頂いております。

【報道機関からのお問い合わせ】ヒロセ電機株式会社 デジタルプロモーション課 課長：山田理絵

hrs.info.2c@hirose-gl.com TEL:045-620-3575

● 特長 BM46 シリーズ

BM46 シリーズは、5G 対応モバイル端末向けに開発されたマルチ RF 対応基板対基板コネクタです。マルチ RF 対応を実現したことにより、「RF×複数個」と「デジタル信号」をひとつのコネクタに収めることが可能になり、セットの小型化と生産性の向上に貢献します。ピッチ 0.35 mm、かん合高さ 0.6mm、奥行き 2.0mm とコンパクトなサイズながら優れた高周波特性を実現しつつ、且つ、金属による補強でコネクタのかん合破損リスクを軽減する堅牢な製品です。



近年、新しい通信規格の急速な発展に伴い、アンテナ数が増加する傾向にあります。従来のケーブルタイプであれば、スマートフォンや PC などの製品内部が配線だらけになってしまいますが、BM46 シリーズを採用することで、ひとつのコネクタで伝送できます。革新的な 5G、IoT 製品を設計製造する上で、デザイン自由度の向上、優れたデザインの創出に貢献しており、スマートフォンやモバイルルーターなど既に多くの製品やモジュールにご採用頂いております。

● 今後の展開

■ FX26 シリーズについて

60 芯で 25 mm のかん合高さに加え、さらなる極数及び高さのバリエーションを展開予定です。

- ・ 極数： 20, 30, 40, 50 芯, 60 芯。
- ・ かん合高さ： 12~25 mm (12, 15, 18, 20, 25 mm)

車載品質を満たす信頼性の高い設計は、同様に厳しい環境に晒されるアプリケーションでもご使用頂けます。

■ BM46 シリーズについて

5G や WiGig、LPWA など新しい通信規格が普及することで、それまで見たことのない新しいデバイスが次々に創出されることが期待されます。BM46 はそうした変化にも対応できる小型、堅牢、高特性を兼ね揃えた RF 対応の基板対基板コネクタです。スマートフォンやルーターに留まらず、更なる市場拡大を目指して参ります。

● 会社概要、関連情報

■ 会社概要

ヒロセ電機 https://www.hirose.com/corporate/ja/about/corporate_data/

■ FX26 シリーズについて

製品画像 <http://prd-4s-public.s3.amazonaws.com/upload/corporate/file/FX26.png>

■ BM46 シリーズについて

製品詳細 <https://www.hirose.com/product/series/BM46>

製品画像 <http://prd-4s-public.s3.amazonaws.com/upload/corporate/file/BM46.png>

■ CES 2020 INNOVATION AWARD PRODUCT

Vehicle Intelligence & Transportation FX26 Series

<https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees/2020/Honorees/F/FX26.aspx>

Mobile Devices & Accessories BM46 Series

<https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees/2020/Honorees/B/BM46.aspx>

【報道機関からのお問い合わせ】ヒロセ電機株式会社 デジタルプロモーション課 課長：山田理絵
hrs.info.2c@hirose-gl.com TEL:045-620-3575